

# Sächsischer Arbeitskreis **VDE / VDI** Elektronik-Technologie

## 24. Treffen des Sächsischen Arbeitskreises Elektronik-Technologie (VDE/VDI)

am **Donnerstag, 15. Juni 2000** **10.00 Uhr**  
bei der **KSG Leiterplatten GmbH in Gornsdorf**  
Veranstaltungsort: **Volkshaus Gornsdorf, Am Andreasberg 5 (ca. 500 m von KSG entfernt)**

### **Thema: Neue Herausforderungen an die Leiterplattentechnik**

|               |                      |  |
|---------------|----------------------|--|
| Chairman:     | Dr.-Ing. Bechtloff   | Geschäftsführer der KSG Leiterplatten GmbH |
| Leitung:      | Prof. Sauer          | IET, TU Dresden                            |
| Organisation: | Dipl.-Ing. Achim Süß | Leiter Vertrieb/Produktentwicklung KSG     |
|               | Dr. Bauer            | IET, TU Dresden                            |

- 10:00 Uhr** **Begrüßung der Teilnehmer**  
**Herr Prof. Sauer TU Dresden, Herr Dr. Bechtloff KSG**
- 10:10 Uhr** **Vorstellung der KSG Leiterplatten GmbH Gornsdorf**  
**Herr Dr. Bechtloff, GF der KSG Leiterplatten GmbH**
- 10:35 Uhr** **Entwicklung der Leiterplatte und ihre Trends in der Zukunft**  
**Herr Süß, KSG Leiterplatten GmbH**
- 11:00 Uhr** **Entwicklungstrends aus Sicht eines Basismaterialherstellers**  
**Herr Willuweit, Produktmanager Anwendungstechnik ISOLA GmbH**
- 11:25 Uhr** **Pause**
- 11:40 Uhr** **Wie sehen optimale Fertigungsunterlagen aus?**  
**Herr Genz, KSG Leiterplatten GmbH**
- 12:05 Uhr** **Kostenbeeinflussende Faktoren**  
**Herr Haustein, KSG Leiterplatten GmbH**
- 12:30 Uhr** **Praktische Erfahrungen zur zerstörungsfreien Prüfung in der Flachbaugruppenfertigung**  
**Herr Dipl.-Ing. Zschiedrich, Prettl Elektronik Radeberg GmbH**
- 12:55 Uhr** **Imbiss**
- 13:45 Uhr** **Oberflächen für die bleifreie Verbindungstechnik**  
**Herr Wandner, Leiter Verfahrenstechnik Enthone-OMI**
- 14:10 Uhr** **HDI – für neue Aufbau- und Verbindungstechniken**  
**Herr Dr. Bechtloff, Herr Süß, KSG Leiterplatten GmbH**
- 14:35 Uhr** **Ultraschall- und Röntgenmikroskopie zur Qualitätsbewertung in der Baugruppentechologie**  
**Herr Dr. Herenz, Herr Daniel, Herr Prof. Wolter, TU Dresden**
- 15:00 Uhr** **Abschlussdiskussion**
- 15:20 Uhr** **Transfer zur KSG Leiterplatten GmbH**
- 15:30 – 17:00 Uhr** **Fertigungsbesichtigung bei der KSG Leiterplatten GmbH**

Teilnahmemeldungen sind bis eine Woche vor der Veranstaltung an Herrn Dr. R. Bauer, TU Dresden, Institut für Elektronik-Technologie erbeten (Fax.-Nr.: 0351/ 463 7069 oder e-mail: r.bauer@iet.et.tu-dresden.de). Aktuelle Informationen sind auch im Internet zu finden unter <http://www.iet.tu-dresden.de>.